

证券代码：688689

证券简称：银河微电

常州银河世纪微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东北证券李玖 东海证券张昊
时间	2021年10月11日
地点	常州银河世纪微电子股份有限公司会议室
公司接待人员姓名	财务部经理（现董事会秘书）李福承 研发部经理庄建军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：常州半导体产业如何、人才引进是否有门槛？ A：常州集成电路产业和苏州无锡比可能存在一定差距，但分立器件相对而言还可以，周边地区交通便利、人才引进不存在明显门槛。公司多年来均践行客观、规范的内控决策机制，秉持务实、科学的用人理念，兼顾人才梯队的优化和人员结构的稳定。</p> <p>Q：分立器件行业是否会过于依赖下游应用？ A：分立器件应用领域广泛，国产分立器件市场占有率也仍有较大的上升空间，基础部件与各行各业均有牵涉，因此销售业绩一定程度上会受经济景气程度影响，但不会过于依赖下游应用。</p> <p>Q：公司芯片自制的比重如何？ 是否会上升？ A：目前公司芯片自产率约 20%-30%，均为自用。在我公司产品中，芯片是材料成本中重要部分，但其主要功能还是配套，因此对于一些用量不大或是较为成熟且供需相对平稳的芯片，公司倾向于选择采取外购的方式，而非高成本地投入生产线。公司不会刻意提高芯片自产率，目前自制比重仍然比较稳定，同时后期也会根据市场需求和成本测算结果的变化及时调整。</p> <p>Q：MOS 管会不会替代二极管三极管？ A：MOS 更多替代的是三极管，且 替代已较为成熟，可预期新增替</p>

	代较少。二极管和三极管是两种不同的工作原理，不需要外围控制，而 MOS 必须要控制。所以虽然原理上 MOS 可以替代，但从实际生产、经济效益角度其实存在替代难度，一般要根据具体应用需求进行选择，并非简单的完全替代关系。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 10 月 11 日

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华西证券熊军
时间	2021 年 10 月 21 日
地点	常州银河世纪微电子股份有限公司会议室
公司接待人员姓名	财务部经理（现董事会秘书）李福承
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 目前芯片生产是怎样的模式?</p> <p>A: 公司具备设计能力的芯片相关产品占报告期各期营业收入比例约为 90%，具备自主设计所需主要品种芯片的能力。但是由于芯片产线的特异性，以及不同种类芯片工艺控制细节各不相同，公司只具备部分功率器件芯片的制造能力。公司产成品种类繁多，所以为了满足客户一揽子采购需求，芯片方面采用自产与外购相结合的模式。</p> <p>Q: 后期是否会扩大用人规模?</p> <p>A: 伴随后期募投项目（尤其是其中的扩产项目）建成投产，用工需求必然会增加，但同时因为自动化程度的不断提升，也会导致人员精简。所以后期用人规模会在一定程度上扩大，同时人均产出也会增长。</p> <p>Q: 如何了解客户未来需求，如何进行产能匹配?</p> <p>A: 很多客户都会提供生产计划，公司根据生产计划及采购订单的情况，对每月生产规划作出调整。同时，公司有产品应用开发工程师，和客户的工程师有长期的合作拓展，当客户有新需求时，公司会通过各种途径在前期介入，尽早根据相关信息判断未来需求，合</p>

	<p>理进行产能匹配。</p> <p>Q: 供需情况如何?</p> <p>A: 目前产能饱满, 公司也积极与客户沟通, 尽可能保持供需关系, 梳理恐慌性囤货, 保持客户黏性也考虑未来发展。公司始终希望投资者能理性看待行业热度和业绩增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 10 月 21 日